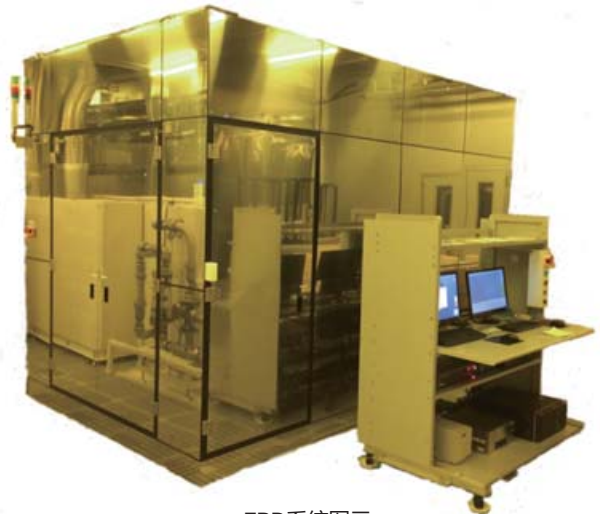


Stealth 300V Series 薄膜MURA Macro检测装置



SEMI系统图示



FPD系统图示

基板整体进行高精度，快速检查

Stealth300V采用线型LED光源照射基板/薄膜表面，并使用超高感度摄像头扫描来自被测物的正反/散射光线，摄取整体图象。然后通过图像分析对表面缺陷进行检出。相对以往的局部检测设备，Stealth可以更高速更全面检出各种表面缺陷。本设备适用于各种薄膜在各种工艺段后的品质检查。如光刻胶，PI薄膜等的曝光MURA,残渣MURA。此外还能对Micro Lens和LED的PSS高度进行整体检查。

设备构成	
基板尺寸	2-12" Wafer或G6~G10玻璃
摄像头	线型传感器摄像头
光源	LED
检查方法	利用正反射/散射两种方法检出
测定时间	1片/1分钟以内 (图象分析时间除外)
测试对象	光刻胶MURA 打印残膜MURA LED PSS高MURA Color Filter MURA等等
Option	Loader System GEM300 CIM 防震系统
参考尺寸	W1950 D2600 H2250 (测试12inch Wafer设备) 多为特制设备, 尺寸不一

